

産業用青色レーザ、 金属加工の課題解決に向けた マイルストーンを達成

マシュー・フィルポット

第2世代の青色レーザシステムは、新しい製造手法を採用することにより、よりコンパクトで、信頼性が高く、処理に応じてスケラブルな、ガルバノスキャナ対応のレーザシステムとなっている。

半導体レーザダイオード技術に基づく第1世代の産業用青色レーザが初めて発表されたのは、2017年である。これらのレーザはその後、主に銅とアルミニウムの溶接や3Dプリントなどの用途に対して、赤外(IR)レーザよりも吸収率が高いというメリットを発揮し、確立されることとなった。しかし、多くの材料加工ソリューションに用いられる産業用2Dガルバノスキャナシステムで使用するには、輝度が足りなかった。米ヌブル社(NUBURU)が発表した第2世代の産業用青色レーザは、これらのレーザの設計と製造における

飛躍的進歩を達成しており、産業用2Dガルバノスキャナシステムでの使用が可能である(図1)。

この飛躍的進歩は、はるかに小さなスポット径と発散角を持つレーザビームを生成する、高度な製造プロセスに基づいている。溶接や3Dプリントといった反射性金属の加工において、レーザビームは一般的に、その輝度、すなわちビームパラメータ積(Beam Parameter Product: BPP)で特徴づけられる。BPPは、(ビームウエストで測定された)ビーム半径とビーム発散半角の積として定義される。第2世代の



図2 第2世代レーザモジュール(モデルBL)

450nmの青色レーザモジュールは現在、125または250Wの出力と5mm*mrاد未満のBPPで提供されており、第1世代のレーザモジュールと比べて出力はほぼ2倍、BPPは3倍に向上している。第2世代はさらに、よりコンパクトで信頼性が高く、出力がスケラブルになるように設計されている。

最も重要な点は、産業用スキャンシステムへの組み込みに十分なレベルの輝度が達成されていて、さまざまな用途において同技術をさらに広範に利用するための扉が開かれたことである。

画期的な製造手法

ヌブル社の第1世代のレーザシステムでは、モジュールのバックプレーン上で手作業で組み立てられてプレパッケージされた、半導体レーザダイオードのリニアアレイが使用されていた。個々の



図1 ヌブル社の第2世代レーザの自動製造が行われるクリーンルーム

表 第1世代/第2世代の製造技術と性能の比較

| モジュール世代 | 1 | 2(自由空間) | 2(ファイバデリバリ) |
|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 発表年 | 2017 | 2023 | 2023 |
| レーザダイオードパッケージ | マルチレーザパッケージ | チップオンサブマウント(COS) | チップオンサブマウント(COS) |
| モジュール駆動方式 | シリアル/パラレル | 個別 | 個別 |
| レーザダイオードのポジショニング | プレパッケージ状態で提供 | 自動 | 自動 |
| レーザダイオードの光学部品配置方法 | ピックアンドプレースの半手動 | 自動 | 自動 |
| モジュールおよびレーザ出力 | 150W | 125または250W | 125または250W |
| デリバリ方法 | ファイバ | 自由空間 | ファイバ |
| ビームパラメータ積(BPP) | 15mm*mrad | <5mm*mrad | <5mm*mrad |
| モジュール体積 | 6950cc | 732cc | 732cc |
| スキャナ互換性 | なし | あり | あり |
| スキャナ接続 | N/A | 直接 | QBHコネクタを介してファイバ端に |

レーザダイオードの光は、高速軸と低速軸のレンズによって、コリメートされる。このプロセスによって、150Wの出力と15mm*mradのBPPを持つレーザモジュールが製造されていた。

第2世代の製造プロセスは、製造、性能、サイズ、信頼性を著しく改善する。その概要は表のとおりである。

第1世代とは、レーザデバイスレベルで既に異なっている。第1世代システムでは、プレパッケージのレーザダイオードリニアアレイが使用されていたのに対し、第2世代システムには、個別のレーザデバイスがチップオンサブマウント(COS)構成で搭載されている。個別のレーザデバイスを採用することには、リニアレーザアレイを駆動

する代わりに、個々のレーザを個別に駆動できるというメリットがある。リニアアレイの場合は、1つのダイオードが故障するとアレイ全体が機能を停止し、レーザ出力が顕著に低下する恐れがある。一方、新設計では、1つのレーザが故障しても光出力の低下は最小限となる。これは、システム全体の信頼性に対してもメリットとなる。

第1世代のレーザアレイでは、ポジショニングとパッケージングはあらかじめ定められており、アレイは駆動プラットフォーム上に手作業で配置されていた。第2世代モジュールでは、自動ピックアンドプレース装置を使って、各デバイスがよりタイトな構成で配置される。このより精密な位置合わせが、

合計輝度の維持に役立つ。

次のステップは、マイクロレンズを各レーザダイオードに取り付けることである。これらのレンズは、非常に非対称のレーザ出力プロファイルを受け取って、コリメートされたビームプロファイルを生成する。第1世代モジュールでは、その配置と固定が半手動で行われていた。第2世代モジュールでは、ロボットによって動的に配置と固定が行われる。つまり、光出力をアクティブに監視して、各レンズの位置と回転が、合計ビーム性能に対して最適化される。この自動アシストのポジショニングとレンズ配置が、第2世代モジュールのBPPが向上した主要要因である。



図3 BLレーザと、産業用スキャナとの自由空間結合用のビームエクパンダー

メリット

新しいCOSベース設計は、大幅な改善をもたらす。おそらく最も印象的なのは、その輝度、すなわち、BPP性能である。溶接や3Dプリントの用途では、出力を加工対象物におけるビーム面積で割った値で定義される、出力密度を最適化することが重要である。加工対象物におけるビーム径は、その発散(BPP)に直接的に関係するが、ビーム発散の最適化には、その労力を上回る価値がある。なぜなら出力密度

は、出力に比例して増加するが、BPPに対しては2のべき乗で増加するためである。従って、第1世代に対する第2世代の出力の増加は著しいが(150Wから250W)、BPPの改善はそれ以上に素晴らしい(15から5mm*mrad)。

第2世代の製造プロセスにより、レーザモジュールのサイズもはるかにコンパクトになる。これを可能にするのは、レーザダイオードの高密度な配置と集光マイクロレンズのタイトな統合における柔軟性である。第2世代レー

ザモジュールの体積は、第1世代モジュールの約10分の1である。

新しいプロセスには、レーザの信頼性を高める効果もある。クラス1000のクリーンルームにおけるサブコンポーネントの前処理と取り扱いの個々のステップを制御することにより、一貫した汚染制御が適用される。ロボットによるアセンブリは、人為的なミスの可能性を減らし、より一貫した製造プロセスにつながる。最も重要な点は、ロボティクスによって、スケラブルで再現可能なプロセスが実現されて、生産能力が高まることである。

自由空間構成

青色レーザを使ったさまざまな材料加工製品がこれまでに開発されているが、そのすべてに溶接レンズとその他のビームデリバリが搭載されている。産業用2Dスキャンシステムに結合できる青色レーザシステムは存在しなかった。新しい第2世代モジュールは、これを可能にするレベルの輝度を達成している。また、サイズがコンパクトであるため、最大250Wのスキャナに直接結合することが可能である(図2)。

図3は、これを行う方法を示している。産業用スキャナに求められるスポット径は最大30mmである。これは、レーザモジュールのスポット径よりもはるかに大きいため、所望のスポット径を生成するために、ビームエクパンダーアセンブリが提供されている。このモジュール/エクパンダーアセンブリが今回初めて、スキャンシステムに直接接続可能となった。

BPPが小さくなったことで、スキャンシステムが使用できるようになっただけでなく、溶接性能も大幅に向上する。図4は、BPP値が異なる、2つの500Wのファイバ結合青色レーザを比

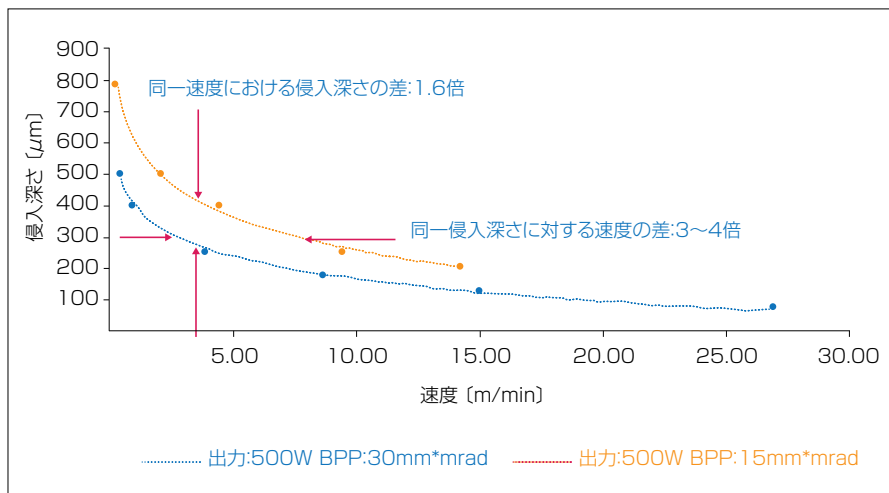


図4 純銅の溶接速度と侵入深さに対するBPPの影響

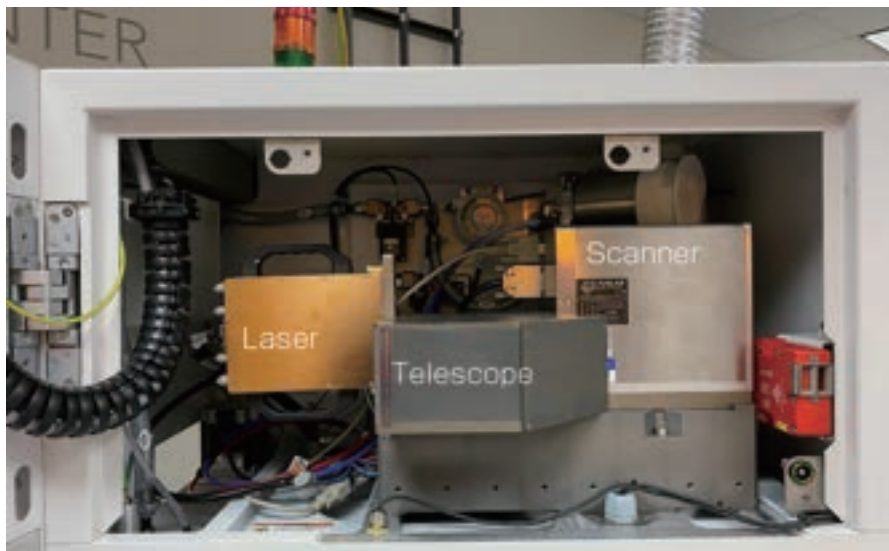


図5 商用粉末床3Dプリンター内部に統合されたレーザモジュール、ビームエクスパンダー、スキャナ

較したものである。青色のデータはBPP値が30mm*mradの場合、赤色のデータは15mm*mradの場合を示している。このデータから、BPP値が2倍になると、さまざまな固定速度における材料への浸透深さは1.6倍になり、同じ浸透深さが得られる速度は3~4倍になることがわかる。金属の溶融とフローをより正確に制御するには、浸透深さが深いほうが望ましく、コストを削減するには、速度が高いほうが望

ましい可能性がある。ここで重要なのは、BPPによって溶接の速度と浸透深さが決まることである。BPPが小さいほど、溶接の速度は高く、浸透深さは深くなる。BPPが5mm*mradの自由空間結合スキャナシステムについても、同様のデータを現在作成中である。

3Dプリント

3Dプリントは、青色レーザが商用利用されているもう1つの分野である。

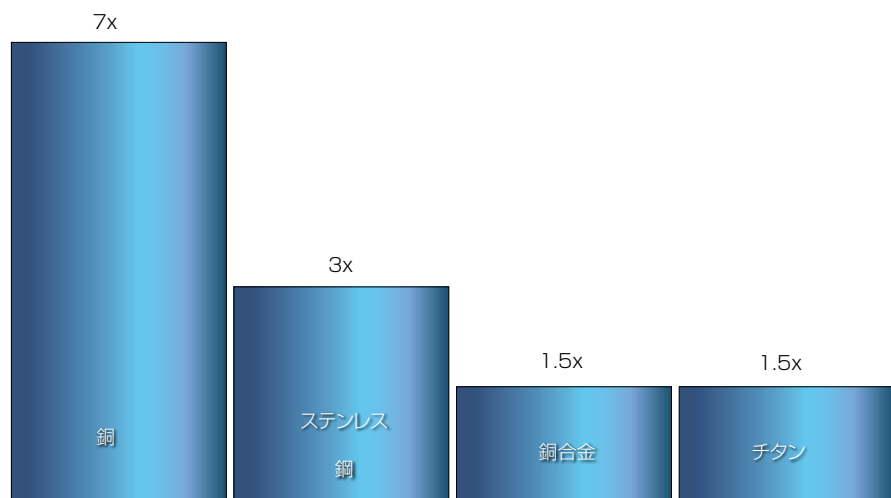


図5 指向性エネルギー堆積法(DED)試験で測定された造形速度(単位:cc/hr)

金属の3Dプリントは、粉末床溶融結合法(Powder Bed Fusion:PBF)、指向性エネルギー堆積法(Direct Energy Deposition:DED)、ワイヤ供給溶融結合法(Wire Fed Fusion:WFF)など、複数の方法で行うことができる。これらの方法は、細部はそれぞれ異なるものの、金属が溶ける(溶融するほど軟らかくなる)まで加熱する必要があるのはすべて同じである。溶接の場合と同様に、その目的は、ビームから金属にエネルギーを転送することである。そのプロセスの効率が高いほど、速度は速くなり、完成品の品質は高くなる。図5は、商用3Dプリンター(粉末床)の中で、レーザモジュールがビームエクスパンダーを介してスキャナに統合されている様子を示している。

IRレーザもこの用途に対して以前から使われているが、青色レーザは、溶接と同じメリットを、レーザアシストの積層造形にも提供する。ヌブル社は最近、DEDに対してIRファイバレーザをBLシリーズの青色レーザに置き換え、2つの技術による結果を同一条件下で比較した。最も重要な指標である造形速度(単位:cc/hour)で、その結果を定量化した(図6)。造形速度はIRレーザと比べて、銅の場合で7倍、ステンレス鋼で3倍、チタンで1.5倍高速だった。

第1世代と比べて、輝度は3倍、出力は2倍になったことで、性能は大幅に向上している。その結果として、レーザ溶接とレーザアシスト積層造形を対象とした産業用スキャンシステムとの新たな統合が可能になっている。

著者紹介

マシュー・フィルポット(Matthew Philpott)は、米ヌブル社(NUBURU)の最高マーケティングおよびセールス責任者。
e-mail: matthew.philpott@nuburu.net
URL: www.nuburu.net